

8 Colloquia / Workshops at the Institute

10th January 2002

Dr. Wolfgang Mertin , Fachbereich Elektrotechnik, Gerhard-Mercator-Universität Duisburg
"Mikro- und Nanocharakterisierung mikroelektronischer Bauelemente mit Raster-Sonden-Techniken"

24th January 2002

Dr. Walter Haeberle, IBM Forschungslaboratorium Zürich, Rüschlikon, Schweiz
„Das „Millipede“ - ein M(N)EMS mit mehr als 1000 Spitzen für die raster-sondengestützte Datenspeicherung“

4th April 2002

Anne-Dorothea Müller, Prof. Michael Hietschold, TU Chemnitz, Inst. für Physik
„Miniaturisiertes Doppel-AFM für den Nichtkontakt-Modus“
(Statusbericht zum Teilprojekt B6)

25th April 2002

Prof. Dr. Bernd Michel, Fraunhofer Institut IZM, Branch Lab Chemnitz
„Mikroverformungsanalyse mit dem nanoDAC-Verfahren“

23rd May 2002

Dr. Heike Angermann, HahnMeitner Institut Berlin
„Chemische Modifizierung von Si-Grenzflächen“

27th June 2002

Dr.-Ing. Detlef Billep, TU Chemnitz, Fakultät f. Elektrotechnik u. Informationstechnik
„Mikromechanische Inertialsensoren“

17th July 2002

Prof. Banmali S. Rawat, University of Nevada, Reno
“WDM/DWDM Technology for Optical Fiber Communications”

5th November 2002

Workshop SFB 379 “Arrays of micromechanical sensors and actuators”

Prof. Dr. Ngyyen, Nam Trung, Technological University of Singapore

Dr. Peter Schwarz, FhG IIS, EAS Dresden

Prof. Dr. Ulrich Gösele, MPI für Mikrostrukturphysik Halle

and reports from/to

M. Schlegel	A2	Multi-Architektur-Modellierung im Systementwurf
F. Bennini	A1	Ordnungsreduktion von FE-Modellen auf Basis der modalen Zerlegung
O. Enge	A6	Modellierung von Strukturvariabilität mechatronischer Systeme
M. Hanf	B2	Methoden der experimentellen Charakterisierung mikromechanischer Arraystrukturen
M. Flaspöhler	B5	Optische Eigenschaften eines Mikrospiegels mit Beugungsgitter für die Anwendung in multispektralen Bildaufzeichnungssystemen
A.-D. Müller	B6	Elektromechanische Eigenschaften und Anwendung einer Doppel-Cantilever-Anordnung für die Rasterkraft-Mikroskopie
C. Lohmann	C2	Herstellung und Charakterisierung mikromechanischer Sensoren und Aktoren basierend auf der neuen Technologieplattform
K. Hiller	C4	Neue Technologie zur Kopplung von Mikromechanik und Elektronik
St. Heinz	C5	Vertikal-FET in oberflächennaher Silizium-bulk-Mikromechanik